



电子行业：深圳大力推动智能终端产业发展，AIoT、DAAS 等产品将持续渗透

2024 年 4 月 16 日

看好/维持

电子

行业报告

事件：

为加快培育发展智能终端产业集群，促进产业迈向全球价值链高端，近日，《深圳市推动智能终端产业高质量发展若干措施》经深圳市政府同意，现已印发实施。

点评：

AIoT 终端涵盖智能手机、个人电脑、PC、智能可穿戴设备以及各类新型智能终端产品，高端化轻量化的终端产品成为产业发展的重要趋势。智能终端产业是深圳市支柱产业，涵盖智能手机、PC、智能电视、智能可穿戴设备以及各类新型 AIoT 终端产品。高端化轻量化的终端产品成为产业发展的重要趋势，高端手机市场、折叠屏市场、VR/AR 市场将成为未来行业的重要增长点。另外，智能座舱、智慧健康、智慧养老、智能家居等新场景持续拓展，推动车载显示、手表、家电等传统终端产品转型升级。

深圳通过鼓励大型企业集团在深单独设立法人主体、现金资助以及设立新品导入（NPI）创新平台等方式，大力推动智能终端产业发展。本次政策包括：（1）鼓励大型企业集团在深单独设立法人主体，将新增的高端手机、智能可穿戴设备、智能家居、VR/AR 等业务落地深圳，对新设立的主体按照年度产值（营收）规模和地方财力贡献予以不超过 2000 万一次性落户奖励。（2）支持高端折叠屏手机、VR/AR 设备、车载视听设备、全屋智能产品等新型智能终端整机及核心元器件的研发及产业化。对项目承担单位按照项目总投资的 20% 给予最高不超过 1500 万元资助。（3）支持具有高端精密制造能力的智能终端龙头企业发挥行业带动作用，设立具有公共服务性质的新品导入（NPI）创新平台，满足各行业“小批量、个性化、敏捷反应”的新型智造需求。

随着智能终端与 AI 密切结合，DAAS 模式将更加专业化，中国市场上的 AI 终端占比将达到 55%。目前 DAAS（Device-As-A-Service）模式在企业应用领域仍以 PC 为主，正在向手机、可穿戴设备等其他终端乃至消费市场扩展，随着 AI 大模型渗透，有望更加专业化。IDC 预测，2024 年 DAAS 市场规模将增长 7%，中国智能终端市场出货量将增长 4%，中国市场上的 AI 终端占比将达到 55%，搭载 AI 功能的终端设备将超过 70%。智能终端产品与 AI 通用大模型结合，终端智能化愈发凸显，DAAS 模式产品有望持续渗透。

投资建议：深圳大力推动智能终端行业发展，高端手机、折叠屏和 VR/AR 市场将成为未来重要增长点，AIoT、DAAS 等产品将持续渗透。另外，智能座舱、智慧健康、智慧养老、智能家居等新场景持续拓展。（1）折叠屏手机推荐统联精密，受益标的：凯盛科技、东睦股份、精研科技；（2）VR/AR 领域推荐伟时电子、清越科技，受益标的：易天股份、兆威机电、三利谱；（3）智能穿戴领域受益标的：中科蓝讯、天健股份、乐心医疗、佳禾智能。

风险提示：产品价格波动、行业景气度下行、行业竞争加剧、中美贸易摩擦加剧。

未来 3-6 个月行业大事：

无

资料来源：恒生聚源

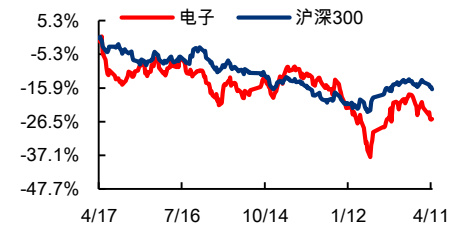
行业基本资料

占比%

股票家数	346	7.52%
行业市值(亿元)	59697.6	7.12%
流通市值(亿元)	49699.04	7.42%
行业平均市盈率	47.41	/

资料来源：恒生聚源、东兴证券研究所

行业指数走势图



资料来源：恒生聚源、东兴证券研究所

分析师：刘航

021-25102913

liuhang-yjs@dxzq.net.cn

执业证书编号：

S1480522060001

相关报告汇总

报告类型	标题	日期
行业深度报告	OLED 显示行业：全面渗透与国产化，中大尺寸布局加速	2024-03-14
行业普通报告	电子行业：顶层设计推动人工智能产业发展，看好算力和 AI 应用板块	2024-02-22
行业深度报告	电子行业：AI 半导体的新结构、新工艺、新材料与投资建议—半导体技术前瞻专题系列之一	2024-01-08
行业深度报告	FPGA 的国产替代现在是什么情况？未来是哪些方向？—“FPGA 五问五答”系列报告五	2023-12-26
行业深度报告	如何理解 FPGA 商业模式？龙头竞争优势的来源？—“FPGA 五问五答”系列报告四	2023-12-25
行业深度报告	FPGA 在各行业究竟用在哪里？未来哪个下游最有机会？—“FPGA 五问五答”系列报告三	2023-12-25
行业深度报告	电子行业 2024 年投资展望：“长鞭效应”再起，科技巨擘勇立潮头	2023-11-29
行业深度报告	电子元器件行业：复盘海外光掩膜行业龙头发展之路，给我们带来哪些启示？	2023-09-28
行业深度报告	电子行业 2023 年中期投资策略：从模式创新到技术创新，拥抱硬件创新浪潮	2023-07-03
行业深度报告	导电胶行业：封测材料替代进行时，看好导电胶领域	2023-05-26
公司普通报告	统联精密（688210）：毛利率环比明显改善，折叠机铰链零部件等新项目需求逐步释放	2023-11-06
公司普通报告	统联精密（688210）：Q1 业绩承压，折叠屏铰链产品陆续导入量产	2023-05-05

资料来源：东兴证券研究所

分析师简介

刘航

复旦大学工学硕士，2022年6月加入东兴证券研究所，现任电子行业首席分析师兼科技组组长。曾就职于 Foundry 厂、研究所和券商资管，分别担任工艺集成工程师、研究员和投资经理。证书编号：S1480522060001。

分析师承诺

负责本研究报告全部或部分内容的每一位证券分析师，在此申明，本报告的观点、逻辑和论据均为分析师本人研究成果，引用的相关信息和文字均已注明出处。本报告依据公开的信息来源，力求清晰、准确地反映分析师本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告中的具体推荐或观点直接或间接相关。

风险提示

本证券研究报告所载的信息、观点、结论等内容仅供投资者决策参考。在任何情况下，本公司证券研究报告均不构成对任何机构和个人的投资建议，市场有风险，投资者在决定投资前，务必要审慎。投资者应自主作出投资决策，自行承担投资风险。

免责声明

本研究报告由东兴证券股份有限公司研究所撰写，东兴证券股份有限公司是具有合法证券投资咨询业务资格的机构。本研究报告中所引用信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。

我公司及报告作者在自身所知情的范围内，与本报告所评价或推荐的证券或投资标的的存在法律禁止的利害关系。在法律许可的情况下，我公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。本报告版权仅为我公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明出处为东兴证券研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

本研究报告仅供东兴证券股份有限公司客户和经本公司授权刊载机构的客户使用，未经授权私自刊载研究报告的机构以及其阅读和使用者应慎重使用报告、防止被误导，本公司不承担由于非授权机构私自刊发和非授权客户使用该报告所产生的相关风险和法律责任。

行业评级体系

公司投资评级（A股市场基准为沪深300指数，香港市场基准为恒生指数，美国市场基准为标普500指数）：
以报告日后的6个月内，公司股价相对于同期市场基准指数的表现为标准定义：

强烈推荐：相对强于市场基准指数收益率15%以上；

推荐：相对强于市场基准指数收益率5%~15%之间；

中性：相对于市场基准指数收益率介于-5%~+5%之间；

回避：相对弱于市场基准指数收益率5%以上。

行业投资评级（A股市场基准为沪深300指数，香港市场基准为恒生指数，美国市场基准为标普500指数）：
以报告日后的6个月内，行业指数相对于同期市场基准指数的表现为标准定义：

看好：相对强于市场基准指数收益率5%以上；

中性：相对于市场基准指数收益率介于-5%~+5%之间；

看淡：相对弱于市场基准指数收益率5%以上。

东兴证券研究所

北京	上海	深圳
西城区金融大街5号新盛大厦B座16层	虹口区杨树浦路248号瑞丰国际大厦5层	福田区益田路6009号新世界中心46F
邮编：100033	邮编：200082	邮编：518038
电话：010-66554070	电话：021-25102800	电话：0755-83239601
传真：010-66554008	传真：021-25102881	传真：0755-23824526